

半自动晶圆刻蚀机

产品名称	半自动晶圆刻蚀机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

半自动晶圆刻蚀机在半导体刻蚀机台对晶圆进行干法刻蚀的过程中，由于晶圆边缘的er(etch rate，刻蚀速率)比中心处的er快，为了**晶圆刻蚀的均匀性，会在机台的内部设置聚焦环(focus ring)，聚焦环被安装在反应离子蚀刻室中晶片周围的平台上，以保护晶圆的边缘，降低晶圆边缘区域的刻蚀速率，**晶圆表面刻蚀的均匀性，如图1所示出的刻蚀机台内部腔体结构中聚焦环1的位置，注入气体4经过分流器3注入腔体中对晶圆2进行刻蚀制程的同时，聚焦环1也随之损耗，晶圆2边缘刻蚀速率较快，同样地，加快了聚焦环1的消耗，因此使用一段时间后，需要机台及时进行pm，以更换新的聚焦环，这样一来缩短了mtbc，影响了机台的产能。

半自动晶圆刻蚀机特点：

- 1.真空腔规格: 材质316不锈钢 L270mm*W280mm*H200mm
- 2.电极：平板气浴电极，材质6061-T6铝合金 功率电极：1 接地电极：1
- 3.电极尺寸：230mm *230mm（*大可处理产品尺寸，可处理8寸晶圆）
- 4.半自动晶圆刻蚀机频率：13.56MHz

5. 功率：0-300W连续可调，可在设备运行中随时调整参数。
6. 气体控制：精密针阀式浮子**计，0-1000ml 2路气体
7. 半自动晶圆刻蚀机真空度测量仪器：2色显示式高精度数字式压力开关（SMC）
8. 控制方式：4.3寸工业控制触摸屏，全手动控制和全自动控制两种控制方式
9. 控制软件功能：界面显示实时工作状态
10. 半自动晶圆刻蚀机规格尺寸：长600mm 宽600mm 高700mm
11. 电极板配置：配备3个卡槽位（接地电极），极板间距离可调整，可按需求调整极板位置